

事業者名	(地独)大阪産業技術研究所								
機器名	高速シリコンディープエッチング装置								
写真									
特徴・用途	本装置は高速にシリコン基板を垂直に深く加工することができる装置であり、新たな電子機器等の製造に不可欠な、小型、低価格、低消費電力のセンサ、デバイスの開発に必要な最先端のMEMS一貫プロセスの中の重要な装置である。								
設置場所	(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター								
利用状況	年月	稼働日数 (日)	依頼試験・ 依頼分析 (件)	技術指導 (件)	試験設備貸出・利用		受託研究・ 共同研究 (件)	その他 (件)	利用件数 計(件)
	平成27年11月	13	0	0	0	0	0	13	13
	平成27年12月	9	0	0	0	0	9	0	9
	平成28年1月	10	0	0	0	0	10	0	10
	平成28年2月	11	0	0	1	3	10	0	11
	平成28年3月	12	0	1	0	0	10	1	12
	平成28年4月	12	0	0	1	1	10	1	12
	平成28年5月	11	0	1	0	0	9	1	11
	平成28年6月	9	1	0	0	0	7	1	9
	平成28年7月	10	0	2	3	5	6	1	12
	平成28年8月	11	0	0	3	4	8	1	12
	平成28年9月	9	0	0	0	0	8	1	9
	平成28年10月	9	4	0	0	0	5	1	10
	平成28年11月	10	0	2	6	6	6	1	15
	平成28年12月	11	0	0	3	3	9	1	13
	平成29年1月	11	1	1	3	3	7	1	13
	平成29年2月	11	0	0	5	5	9	1	15
平成29年3月	11	0	0	7	7	9	1	17	
利用者等の声	<p>日本国内に一般の企業等が簡略な申請で利用でき、専門家からの確な技術指導を受けられる高速シリコンディープエッチング装置を利用できる機関が無かった。そのため本装置を日本全国の大学(北海道, 大阪府), 企業(関東, 中部, 関西)が利用している。本装置の導入で、新規のMEMSデバイスの開発ができるようになり、大変喜んでる。</p> <p>本装置を用いたMEMS実習講座を開催した。内容はMEMS超音波センサの作製であり、実習講座の受講者からは大変役立ったと高い評価を受けた。</p>								
補助事業概要の広報資料	http://hojo.keirin-autorace.or.jp/shinsei/document/list/kikai/h27/pdf/27-051koho.pdf								